

SMT 158HA底部填充膠 产品数据表

卓越的熱循環性能

優異的機械衝擊性能

高良率

简介

SMT 158HA 是一種快速流動、低溫慢固化的高純度液態環氧底部填充膠。此材料可用於倒裝晶片和晶圓級晶片封裝應用。它也適用於各種先進封裝中的裸晶片保護，例如記憶卡、晶片載體、混合電路和多晶片模組。該產品專為高產量和環保生產環境而設計，尤其適用於對製程速度和機械衝擊有較高要求的應用。該材料易於點膠，可最大限度地減少應力，並提供卓越的可靠性（例如，耐溫度循環性能）和出色的機械強度。

物理特性

产品名称	SMT 158HA底部填充膠
颜色	白色
未固化材料性能	
项目	数值
比重 (ASTM D1475-60)	1.8 g/cc
粘度 (Brookfield, 0.5 rpm)	5-8.0k cp
固化后材料性能	
(Tg) (ASTM D3418-82)	157 ° C
C.T.E (ASTM E831) PPM/°C	$\alpha_1 = 22$ $\alpha_2 = 71$
搭接剪切强度 (FR4/FR4)	3600 psi

提取离子(MIL-STD-883E)	
Na+	<5ppm
K+	<5ppm
F-	<5ppm
Cl-	<10ppm
表面绝缘电阻 (J-STD-004)	通过 (Pass)

推荐干燥/固化工艺

在 150°C 下加热 3 小时或在 165°C 下加热 2 小时。根据客户要求，可提供其他固化方案。

储存与保质期

在 -40 °C 以下条件下，如材料保持于密封的原始容器中，保质期为 6 个月。
超过该存储期限，材料粘度可能会升高。请避免材料受到水分、挥发损失及异物污染，否则可能对产品的加工性能产生不利影响。

安全信息

SMT 158HA 为环保型、无毒材料。但在操作和使用过程中，仍建议遵循基本的工业卫生规范。有关更详细的安全信息，请参阅本产品的 材料安全数据表。

包装规格

SMT 158HA 毛细管底部填充胶系列产品提供 10cc 和 30cc 两种规格。其他包装规格可依客户需求提供。如需订购信息，请联系 YINCAE 公司。